TCADシミュレーションを用いた ATLAS実験 SCT検出器の放射線損傷の評価







■CERN LHC加速器

✓世界最高の衝突エネルギーを誇る陽子・陽子衝突型加速器

✓周長27km

✓重心系エネルギー13.6TeV

■ATLAS検出器

- ✓陽子・陽子衝突から発生する粒子を検出
- ✓ヒッグス粒子の発見・検証

✓標準模型の検証

✓新物理の探索(超対称性粒子,ダークマ ター,余剰次元…)



ATLAS 検出器





4

■2011~2018年(Run1, Run2)までで積分ルミノシティ190fb⁻¹の統計量

✓ヒッグス物理

2012年ヒッグス粒子発見 ➡ 精密測定へ

カップリング測定、稀な崩壊やダイヒッグス過程などの探索

>新粒子・新物理探索

より高質量な粒子・稀な過程を狙った解析や、新しいフェーズスペースの探索 ■LS2が終了し昨年 Run3スタート、積分ルミノシティ450fb^{-|}目指す ✓ソフトウェア・ハードウェアのアップグレード、13.6TeVへエネルギー上昇

Run3 2022/2023 ATLAS オペレーション

- ◆ ピークルミノシティは速やかに上昇
- ➡以前のLS後より素早く上昇
- LHCオペレーションに対する理解が進んだ恩恵

- ◆ 積分ルミノシティも安定して増加
- ➡LHCより約40.7fb⁻¹供給、ATLASで37.8fb⁻¹取得
- ◆ 今後の予定
 - 2023: p-p ~70/fb
 - 2024: p-p ~95/fb
 - 2025: p-p ~100/fb
 - Total: ~300fb



ストリップ型シリコン飛跡検出器 Semiconductor Tracker(SCT) 6

- ◆ ATLAS実験におけるストリップ読み出し方式の内部飛跡検出器
 - ▶ 各モジュールは表裏に各2枚ずつ、 4枚のセンサーから構成
 - 1モジュールあたり768×2ストリップ(ピッチ80µm長さ12.8cm)
- ◆ SCT全体は4088モジュールで構成
 - ▶ 4 層のbarrel部と 2×9層 endcap disks部



シリコン検出器による荷電粒子の検出



◆ SCTはp-in-n型のシリコンセンサ

◆最大収集電荷量~3fC

◆荷電粒子の通過に伴い空乏層で電子正孔対が発生
 > ストリップ電極で誘導電荷を読み出し
 ➡ 閾値1fCでヒット判定

7

◆ 収集電荷量は空乏層の広がりに比例して増加
 → 運転電圧はセンサ全体が空乏化するように印加

放射線損傷による電流値と全空乏化電圧の変化



- ◆ 放射線損傷が小さいときはストリップ電極がある面から空乏化が進行
 - > 放射線損傷によって、バルクがp型に反転、裏面から空乏化進行
 - ➡高い検出効率達成には、バルク全空乏化後にストリップ間の電気的分離(空乏化)が必要
 - ▶ ハンブルグモデルではストリップ間空乏化に必要な電圧は評価できない



TCADシミュレーション 2Dモデルと放射線損傷

◆ SCTセンサーを再現した2Dモデル



➡2Dモデルに対して放射線損傷(表面損傷・バルク損傷)を導入し、シミュレーション

表面損傷(Total Ionizing Dose, TID) <u>酸化膜電荷</u> <u>Si/SiO₂界面準位</u> →先行研究(<u>NIMA924(2019)198</u>)を参考 に電荷密度・界面準位密度を計算



バルク損傷のTCADにおけるモデル化



捕獲断面積(σ)と Deep Acceptor密度 (N_{acc})の決定



I-Vシミュレーション:実測・ハンブルグモデルとの比較

- ◆2015年~2025年までの全空乏化電圧・電流値が概ね一致
 - > SCTの放射線損傷を説明する適切なパラメータセッティング



ストリップ間空乏化電圧(V_{Separation})評価 :ノイズ分布とTCAD C_{int}-V特性



14

実データとTCADシミュレーションでのV_{separation}の比較



>
$$(V_{\text{Separation,TCAD}} / V_{\text{Separation,Noise}}) \sim 0.7$$

Run3終盤までの予測、高検出効率となる電圧との比較



◆TCAD評価方法でのRun3終盤の予測

▶ V_{Separation,TCAD} ~245V
 ▼ V_{Separation,TCAD} / 0.7 ~350V (V_{Separation,Noise}相当)

 V_{Separation,TCAD}は、高検出効率(95%目安)を達成する電圧(V_{95%})に対して全空乏化電圧より良い見積 もり指標となるが、まだ過小評価
 ⇒今後、MIP入射シミュレーションによって収集電荷効率・検出効率の評価

まとめ

- ♦ SCTの放射線損傷を理解するためTCADシミュレーションを実施
 > 実測・ハンブルグモデル予測の電流・全空乏化電圧と比較して整合性のある結果
- ◆ C_{int}-Vシミュレーションを用いてストリップ間空乏化電圧(V_{Separation,TCAD})を推定 > 実測のNoise評価によるV_{Separation,Noise}に対し、(V_{Separation,TCAD} / V_{Separation,Noise})~0.7

◆TCAD評価によるRun 3終了時点の予測



◆ V_{Separation,TCAD}はV_{95%}に対して全空乏化電圧より良い見積もり指標となるが、まだ 過小評価

➡今後、MIP入射シミュレーションによって収集電荷効率・検出効率の評価